

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2024-002

浙江东尼电子股份有限公司 关于重大合同的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年1月5日，公司子公司东尼半导体与下游客户T签订《采购合同之补充协议》。东尼半导体具备生产能力，但经双方确认，因中途产品检测设备更换，导致SF的判断标准不一致，使得得出的TUA数据不一致，因此东尼半导体2023年交付计划未能完成。东尼半导体同意2024年免费供应8英寸碳化硅衬底作为补偿，以弥补由此影响下游客户T交货而造成的损失。2024年、2025年双方合作不变，供应价格及其他约定以双方每月另行签订的补充采购订单为准。

● 在后续合同履行过程中，如遇宏观政策、市场环境、产品品质、运营管理等因素影响，可能导致合同无法如期、全面履行或被取消，并承担相应的违约责任，赔偿违约金。公司将积极做好相关应对措施，加强风险管控，保障合同正常履行。敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、重大合同概况

2023年1月9日，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）子公司湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）与下游客户T签订《采购合同》（以下简称“原《采购合同》”），约定东尼半导体2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片，含税销售金额合计人民币6.75亿元；2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片，最终单价和具体交付时间由双方在前一年第四季度协商确定。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》于2023年1月10日披露的《东尼电子关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-002，以下简称“原公告”）。

二、重大合同进展情况

经双方确认，东尼半导体 2023 年交付计划未能完成，主要系因中途产品检测设备更换，导致 SF 的判断标准不一致，使得得出的 TUA 数据不一致。原产品检测设备标准为日本 lasertec 的 sica88，中途市场客户改用美国 KLA 的 candela8520 检测设备为标准，东尼半导体根据要求重新定购进口检测设备，周期较长需 5 至 8 个月。双方于 2023 年 7 月邮件确认 2023 年交付计划的差异不视为违约，后于 2024 年 1 月签订《采购合同之补充协议》，东尼半导体同意 2024 年免费供应 8 英寸碳化硅衬底作为补偿，以弥补由此影响下游客户 T 交货而造成的损失。

碳化硅产品处于高速发展期，市场需求不断变化，下游客户 T 要求的规格指标等也不断变化，东尼半导体需根据不同的规格指标调整工艺参数，生产成本随之变化。为满足各自不同的诉求，经友好协商，双方认为原《采购合同》一年一签的形式已不合时宜，因此补充协议约定后续东尼半导体将按照市场价向下游客户 T 供应 6 英寸碳化硅衬底，供应价格及其他约定以双方每月另行签订的补充采购订单为准。双方一致同意，自 2024 年 1 月 1 日开始，原公告中第三章第(一)节“5、违约责任”的重新约定如下：第(2)(3)款删除，其余条款不变。

三、对公司的影响

本次交易不涉及关联交易，亦不会产生同业竞争。

在后续合同履行过程中，如遇宏观政策、市场环境、产品品质、运营管理等因素影响，可能导致合同无法如期、全面履行或被取消，并承担相应的违约责任，赔偿违约金。公司将积极做好相关应对措施，加强风险管控，保障合同正常履行。敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 6 日